

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年10月16日(2014.10.16)

【公開番号】特開2013-58663(P2013-58663A)

【公開日】平成25年3月28日(2013.3.28)

【年通号数】公開・登録公報2013-015

【出願番号】特願2011-196819(P2011-196819)

【国際特許分類】

H 05 K 1/02 (2006.01)

H 05 K 3/34 (2006.01)

H 05 K 3/30 (2006.01)

【F I】

H 05 K 1/02 C

H 05 K 3/34

H 05 K 3/30

H 05 K 1/02 F

【手続補正書】

【提出日】平成26年9月2日(2014.9.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

穴が形成された基板と、

前記基板の表面のうち、前記穴の少なくとも一部を含む第1領域に接合されるイメージヤと
を備える回路基板。

【請求項2】

前記基板の裏面のうち、前記穴の少なくとも一部を含む第2領域に、第1の温度調整部材、又は第2の温度調整部材が装着される
請求項1に記載の回路基板。

【請求項3】

前記イメージヤの裏面と前記第1の温度調整部材又は前記第2の温度調整部材との間に
、さらに、第3の温度調整部材が挿入される
請求項2に記載の回路基板。

【請求項4】

前記第3の温度調整部材は、弹性体の熱伝導体シートを含む
請求項3に記載の回路基板。

【請求項5】

前記第3の温度調整部材は、熱伝導グリスを含む
請求項3に記載の回路基板。

【請求項6】

前記第1の温度調整部材は、温度センサを挿入する挿入孔を有するヒートシンクである
請求項2乃至5のいずれかに記載の回路基板。

【請求項7】

前記第2領域に装着された前記第2の温度調整部材を、前記第2領域に圧着する弹性体

をさらに備える

請求項2乃至6のいずれかに記載の回路基板。

【請求項8】

前記第2の温度調整部材は、温度センサを挿入する挿入孔を有する温度調整プレートを含む

請求項2乃至7のいずれかに記載の回路基板。

【請求項9】

前記基板と前記イメージヤは、半田及び樹脂により接合されている

請求項1乃至8のいずれかに記載の回路基板。

【請求項10】

前記第1領域に接合された前記イメージヤを、前記第1領域に固定する固定用部材をさらに備える

請求項1乃至9のいずれかに記載の回路基板。